

PALTEK

(JASDAQ:7587)

**2014年12月期 第3四半期
決算説明資料**

2014.11.6 (木)

FY2014 Q3 Results Reporting

© 2014 PALTEK Corporation. All rights reserved.

アジェンダ

- ① 2014年12月期 第3四半期
業績結果**
- ② 2014年12月期 業績予想**
- ③ 収益向上への取り組み**

1

2014年12月期 第3四半期 業績結果



連結業績結果(第3四半期累計期間)

(百万円)	2013年第3四半期		2014年第3四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	12,453	100.0%	17,423	100.0%	4,970	39.9%
売上総利益	2,333	18.7%	2,554	14.7%	220	9.5%
販管費	1,739	14.0%	1,955	11.2%	216	12.4%
営業利益	594	4.8%	599	3.4%	4	0.8%
経常利益	568	4.6%	573	3.3%	5	0.9%
四半期純利益	326	2.6%	332	1.9%	6	1.9%
1株当たり四半期純利益	28.58円	—	29.11円	—	0.53円	

主な増減要因

- 売上高は、半導体事業が大幅に増加
- 売上総利益は、売上総利益率は低下したものの、売上高の大幅増により増加(売上総利益率低下の要因は後述)
- 販管費は、H.265/HEVCコーデック製品の開発費、及び6月に設立した(株)テクノロジー・イノベーションの事業運営費用の計上により増加

(百万円)	2013年第3四半期		2014年第3四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半 導 体	11,542	92.7%	16,451	94.4%	4,908	42.5%
デ ザ イ ン サ ー ビ ス	849	6.8%	890	5.1%	41	4.8%
そ の 他	61	0.5%	81	0.5%	20	33.8%
売 上 高 合 計	12,453	100.0%	17,423	100.0%	4,970	39.9%

主な増減要因

- 半導体事業は、通信インフラ、計測機器、医療機器、オフィス機器、ファクトリーオートメーション向け等が増加

■ 売上総利益率の低下は、以下の2つが要因

- ・ ドル円相場により変動する仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額の増減が、2013年第3四半期では+249百万円であったが、2014年第3四半期では+5百万円となった

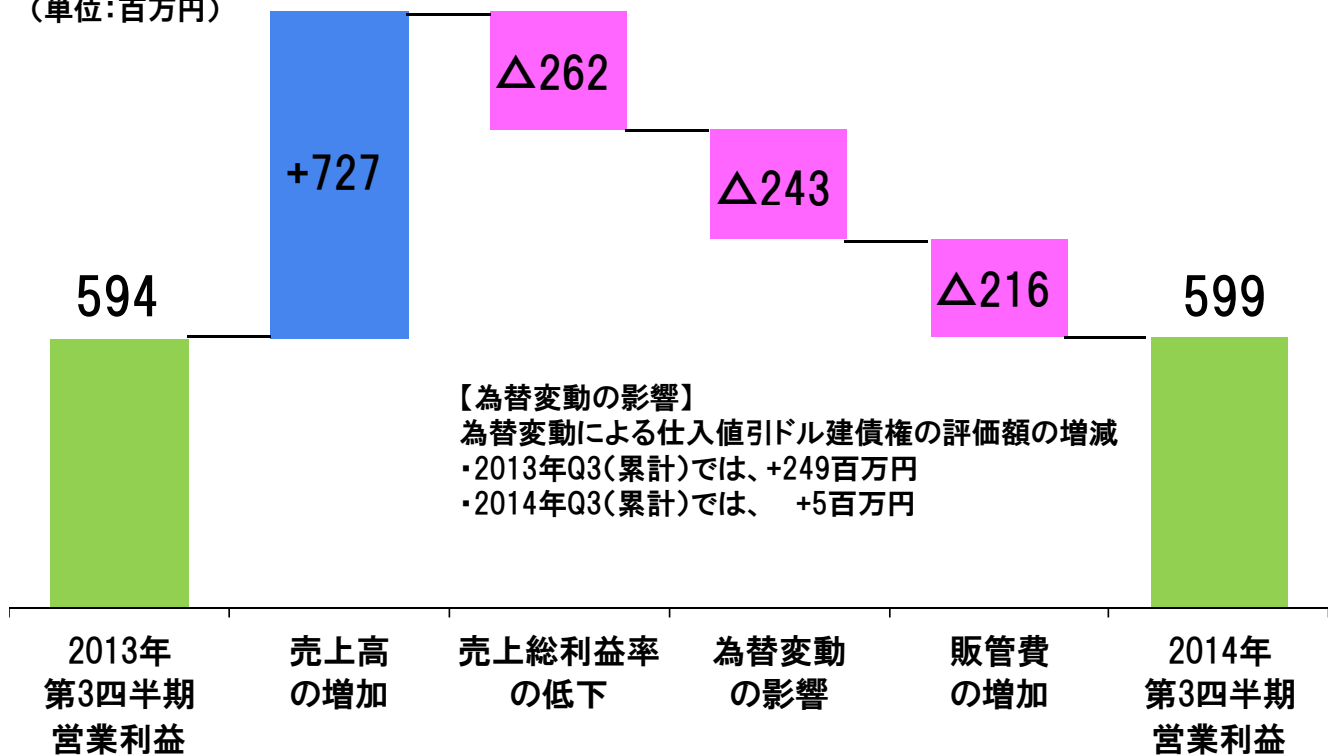
(※仕入値引ドル建債権の説明は、本資料の参考資料に記載)

(百万円)	2013年第3四半期		2014年第3四半期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売 上 総 利 益	2,333	18.7%	2,554	14.7%
(うち為替の影響額)	249	2.0%	5	0.0%
売 上 総 利 益 (為替の影響を排除)	2,084	16.7%	2,549	14.6%

- ・ 半導体事業において、売上総利益率の低い案件の売上高が増加

営業利益の増減分析

(単位:百万円)



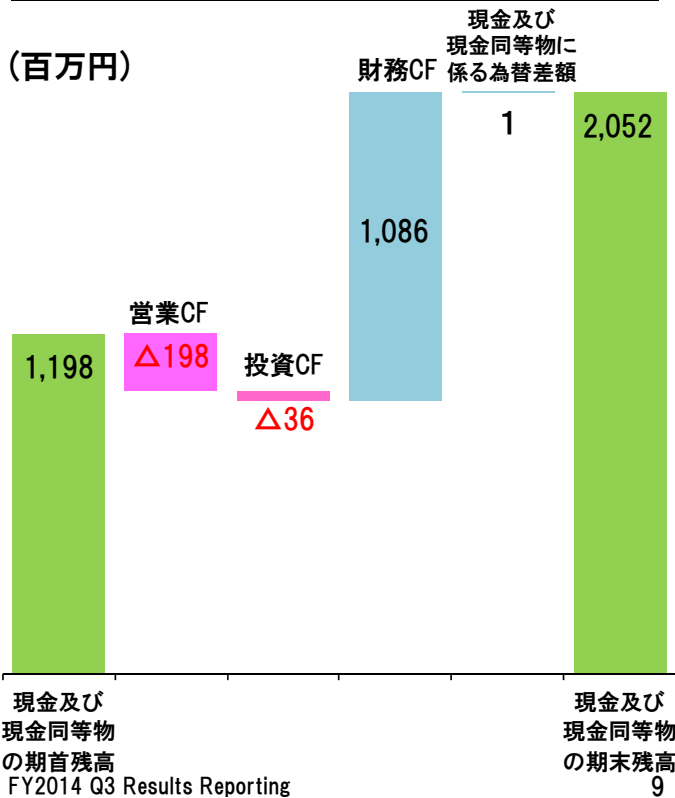
連結貸借対照表の状況

		(百万円)	2013.12末	2014.9末	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金		1,198	2,052	853	借入れの実施等により増加
	売上債権		4,562	4,448	△113	
	商品		2,258	2,546	287	商品の調達に時間を要するため在庫を積み増す
	その他流動資産		2,261	3,147	886	主に未収入金が増加
	固定資産		606	599	△6	
資産合計			10,886	12,794	1,907	
負債純資産内訳	仕入債務		759	958	199	
	短期借入金		880	2,080	1,200	仕入債務の支払のため増加
	その他流動負債		649	906	257	
	固定負債		323	334	10	
	純資産		8,274	8,515	241	
負債・純資産合計			10,886	12,794	1,907	



連結キャッシュ・フローの状況(第3四半期累計期間)

2014年第3四半期のキャッシュフローの動き



(百万円)	2013年第3四半期	2014年第3四半期
現金及び現金同等物の期首残高	1,739	1,198
営業CF	△2,739	△198
投資CF	△38	△36
財務CF	2,723	1,086
現金及び現金同等物の期末残高	1,684	2,052

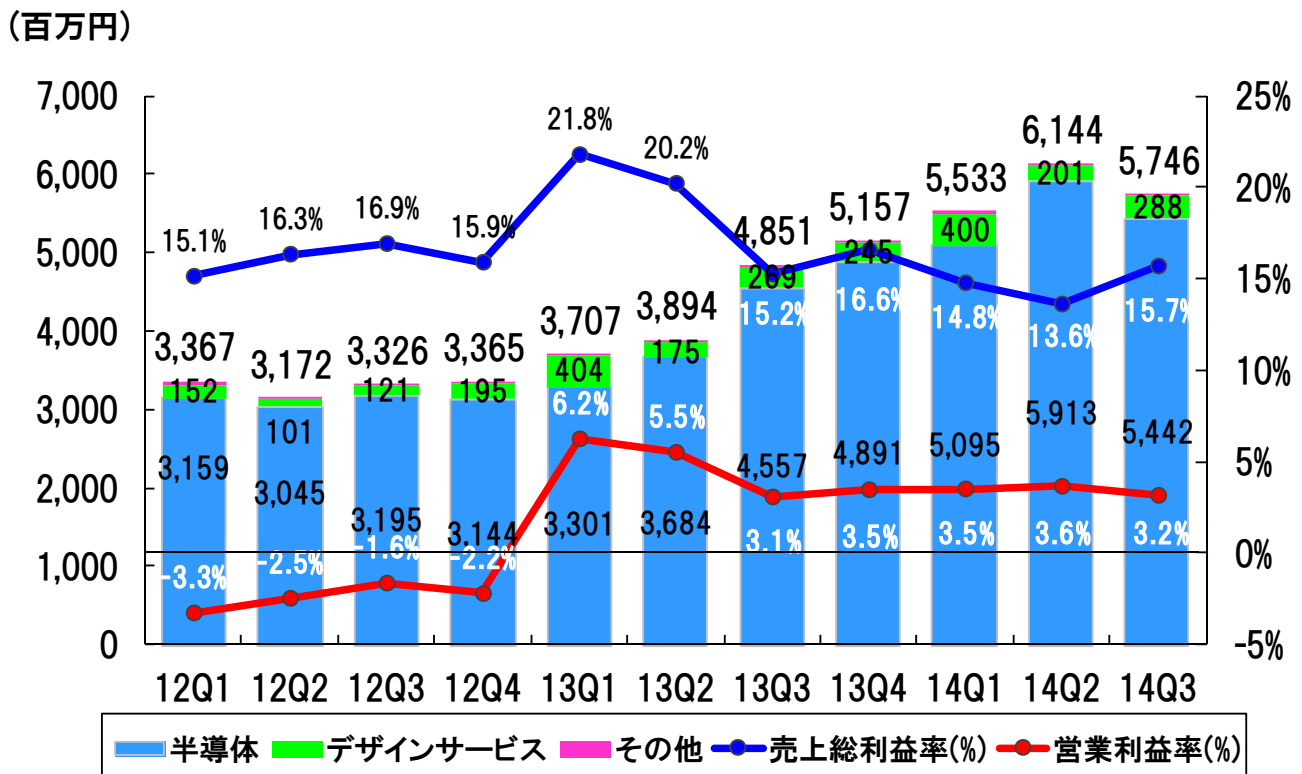
2014年第3四半期のキャッシュフローの動き

- 営業CF: たな卸資産及び未収入金が増加したこと等により支出
- 投資CF: 子会社(株)テクノロジー・イノベーションで事業譲受したこと等により支出
- 財務CF: 借入れの実施等により収入

© 2014 PALTEK Corporation. All rights reserved.

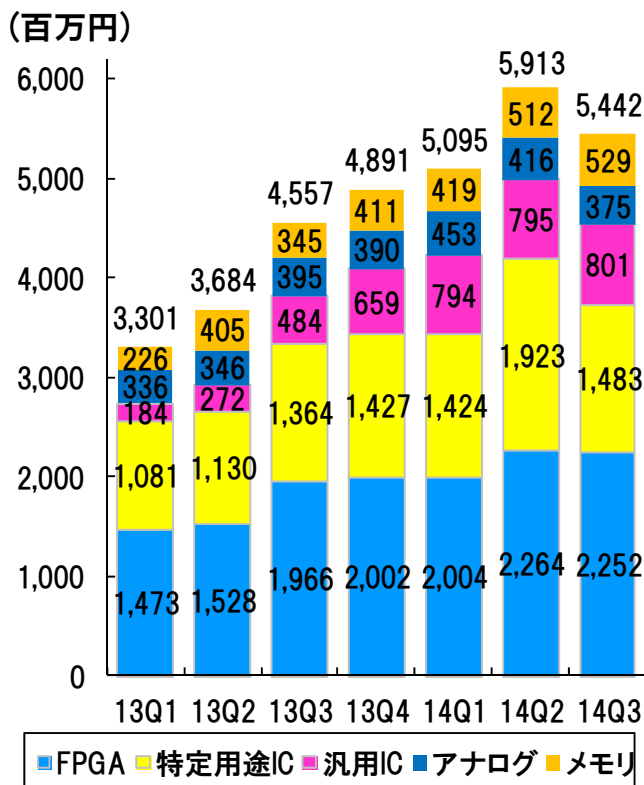


連結業績の四半期推移



事業別の実績

半導体事業の状況（製品別）

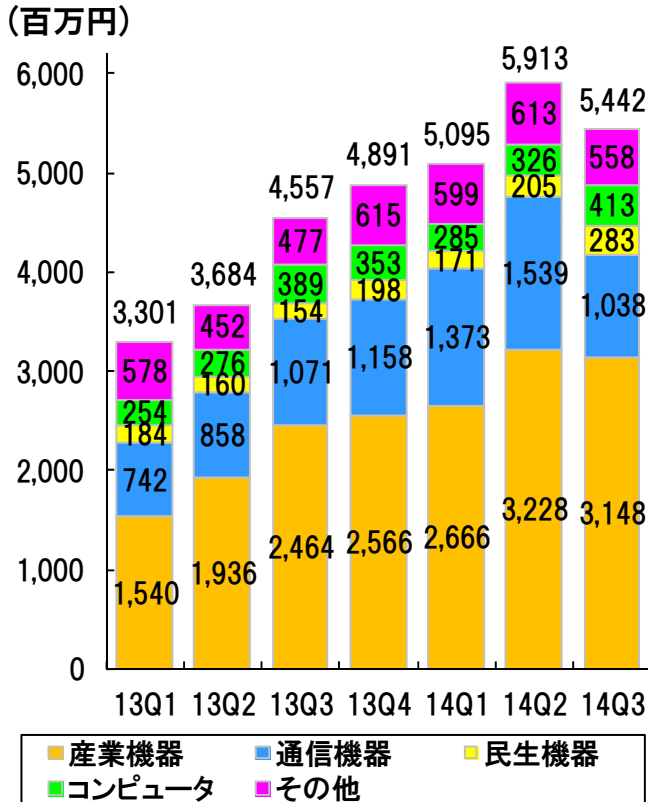


四半期業績の推移

- FPGA**
LTE基地局等の通信インフラ向けは減少するも、通信用計測機器向けが堅調
- 特定用途IC**
通信インフラ、ブロードバンド通信機器向けが減少
- 汎用IC**
オフィス機器向けが堅調
- アナログ**
ファクトリオートメーション、通信機器向けが若干減少
- メモリ**
民生機器向けが堅調

※ 2014年12月期第2四半期より「PLD」というカテゴリを「FPGA」に名称変更しております。

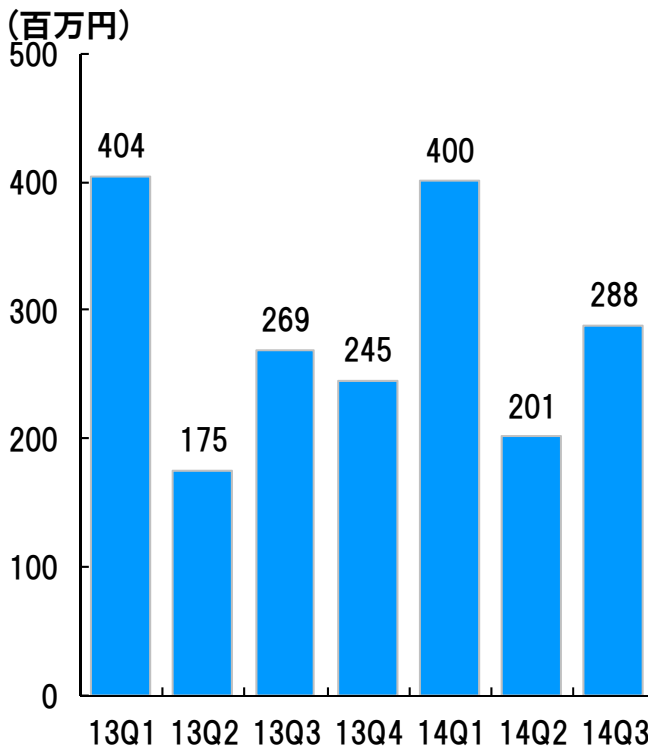
半導体事業の状況（用途別）



四半期業績の推移

- 産業機器**
 計測機器向けは堅調に推移するも、医療機器、ファクトリーオートメーション向け等が若干減少
- 通信機器**
 LTE基地局等の通信インフラ、ブロードバンド通信機器向けが減少

デザインサービス事業の状況



四半期業績の推移

- 医療機器、産業機器向けが堅調**
- デザインサービス事業においては、お客様(3月決算会社)の予算との連動性が高いため、第2四半期の売上高が最も低い傾向**

2

2014年12月期 業績予想

2014年12月期 業績見直しについて

ドル円相場の急速な円安進行を受け、 利益に関して業績予想を上方修正

■ 売上高について

- 売上高はほぼ前回業績予想通りに推移

■ 営業利益について

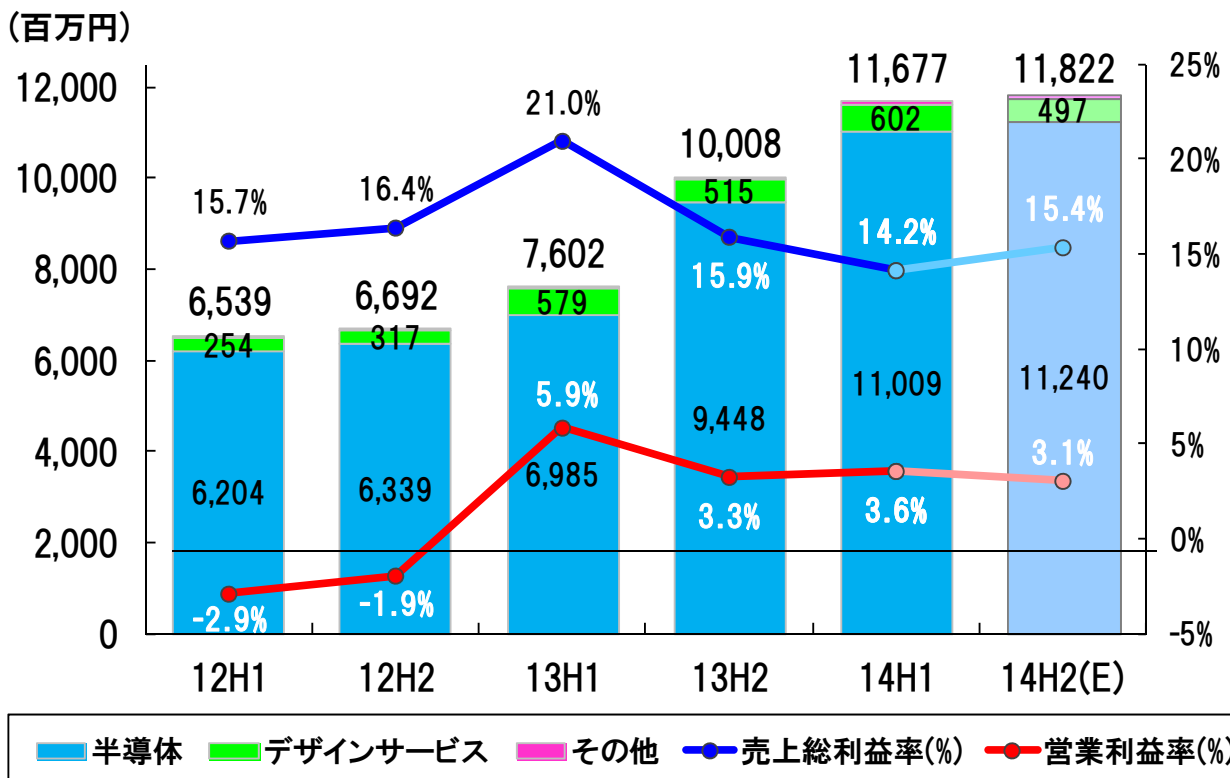
- ドル円相場が急速に円安に進行していることにより、当社が仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額が増加することが見込まれるため、原価を押し下げ、営業利益は増加する見通し

■ 経常利益・当期純利益について

- 営業利益が増加したことにより、業績予想を上回る見通し

(百万円)	修正予想(7/25)			修正予想(11/6)			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	11,677	11,822	23,500	11,677	11,822	23,500	0	0.0%
売上総利益	1,653	1,661	3,315	1,653	1,816	3,470	155	4.7%
売上総率	14.2%	14.1%	14.1%	14.2%	15.4%	14.8%	—	—
販管費	1,235	1,439	2,675	1,235	1,454	2,690	15	0.6%
営業利益	418	221	640	418	361	780	140	21.9%
営業利益率	3.6%	1.9%	2.7%	3.6%	3.1%	3.3%	—	—
経常利益	389	270	660	389	410	800	140	21.2%
当期純利益	228	161	390	228	241	470	80	20.5%

業績予想の推移



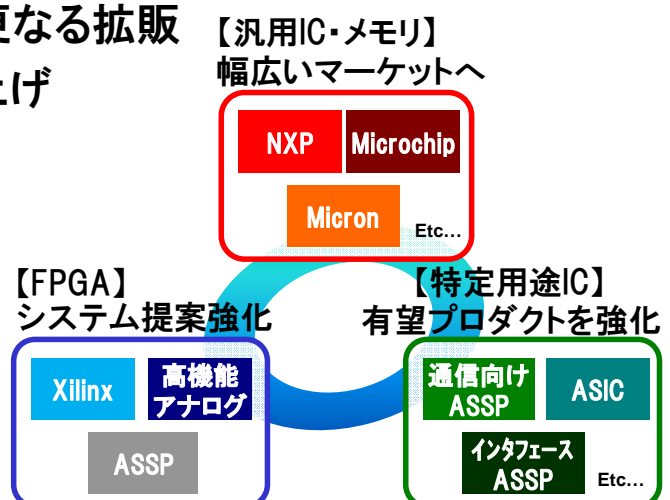
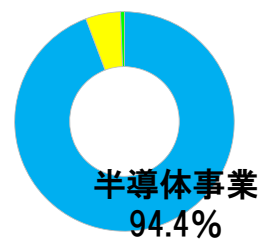
3

収益向上への取り組み

半導体事業

- 事業の位置づけ: 基盤事業
- 事業の方向性
 - 安定的に収益を確保する事業を目指す
- 戦略
 - 中核製品であるFPGAの更なる拡販
 - 第2の柱となる製品の立上げ
 - 成長市場への注力
 - ローコストオペレーションの実施

14Q3(累計)売上構成比



■ 中核製品であるFPGAの更なる拡販



- ・ 新規顧客拡大に向けた取り組みを推進

■ 第2の柱となる製品の立上げ

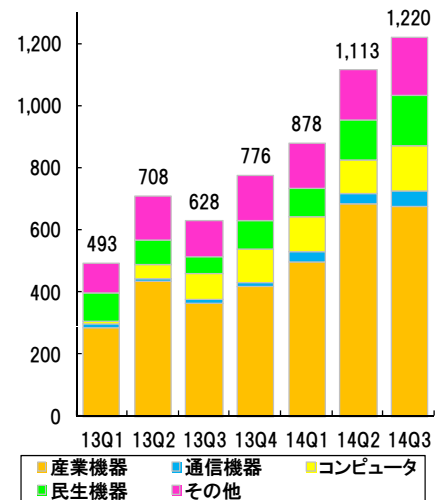
- ・ 第2の柱となる製品は産業機器向けを中心に増加中



■ 成長市場への注力

- ・ 6月に設立した(株)テクノロジー・イノベーションにおいて、特定顧客向けに人感センサーの信号処理ICを開発中

第2の柱となる4製品の売上推移



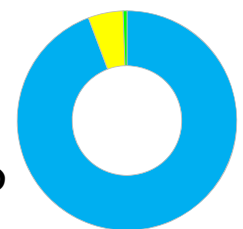
■ 事業の位置づけ: 成長事業

■ 事業の方向性

- ・ 日本メーカーが得意とする医療、放送等の産業分野、通信分野の開発をサポートし、高収益であるデザインサービス事業を成長させる

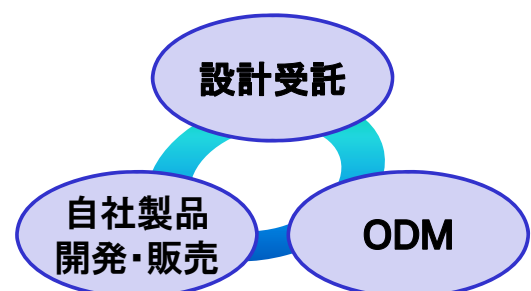
14Q3(累計)売上構成比

デザインサービス事業
5.1%



■ 戦略

- ・ 設計受託の強化
- ・ ODMの更なる展開
- ・ 自社製品開発・販売
 - 既存H.264コーデック装置等の販売強化
 - 4K対応H.265コーデック装置の開発・販売



- 子会社である(株)エクスプローラが
2014年国際放送機器展(Inter BEE 2014)に出展
 - ・ 開催日 : 2014年11月19日(水)~11月21日(金)
 - ・ 場所 : 幕張メッセ (ブース:ICT/クロスメディア部門 /ホール6 /6402)
- 展示品目
 - ・ UltraHD/4K対応H.265/HEVCコーデック装置デモ
 - ・ 超低遅延 H.265/HEVCコーデック装置デモ
 - ・ H.264小型ライブ中継伝送装置 多点ライブデモ
 - ・ 自動レート制御デモ
- 今後普及する映像符号化方式H.265/HEVCのコーデック装置、
現在広く使われている映像符号化方式H.264のコーデック装置に
関するデモを行い、より具体的な提案を実施

自社製品の開発状況

エクスプローラ : コーデック製品開発

- レート制御機能搭載4K対応H.265コーデック装置
 - ・ 現在も開発を進めている状況。販売開始時期は2014年末
 - ・ 11月開催のInter BEE 2014でデモ展示。新規顧客の獲得を目指す



- 超低遅延8K対応HEVC-ECFによるハイブリッド配信装置
 - ・ 2016年9月販売開始を目指し、開発を継続中
 - ・ HD対応の超低遅延H.265/HEVCコーデック装置をInter BEE 2014でデモ展示

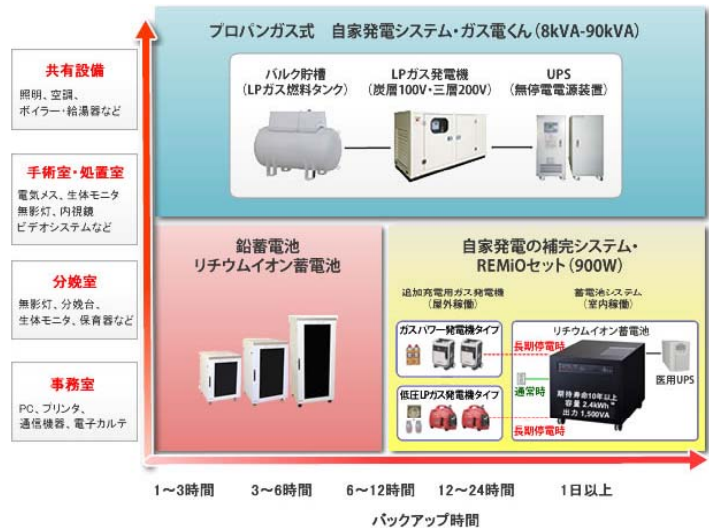
■ 事業の位置づけ: 将来に向けた新規事業

■ 事業の方向性

- 収益拡大に向けて、今後の成長が見込まれるエネルギー分野での事業を構築する

■ 戦略

- 長時間(72時間以上)提供可能な病院向け停電対策システムの構築および販売
- ニーズに基づいた新製品ソリューションの構築



FY2014 Q3 Results Reporting

導入事例

■ 医療法人清風会 岡村産科婦人科 (愛知県)

- 導入の背景
 - 病院全体の設備見直しに伴い、停電時にも長時間電力供給が可能な発電機を検討
- 導入結果
 - 9kVA / 60HzのLPガス発電機を1台導入
 - 停電時に、照明に加えて手術室、LDR、新生児処置室、新生児室、ナースステーションサーバー室の電力バックアップが可能に



病院外観



発電機



分電盤と制御版

参 考 資 料

FY2014 Q3 Results Reporting

© 2014 PALTEK Corporation. All rights reserved.

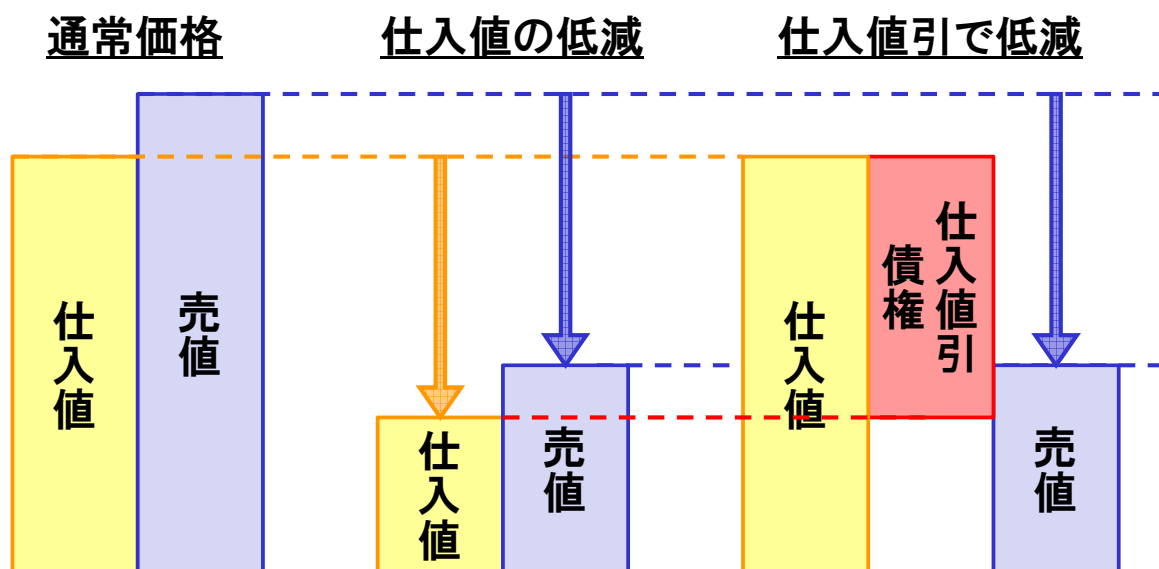


2014年12月期 製品別業績予想

(百万円)	2014年12月期 修正予想 (7/25)			2014年12月期 修正予想 (11/6)		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期
半導体	11,009	11,240	22,250	11,009	11,240	22,250
FPGA	4,268	4,331	8,600	4,268	4,331	8,600
特定用途IC	3,347	3,202	6,550	3,347	3,202	6,550
汎用IC	1,589	1,810	3,400	1,589	1,810	3,400
アナログ	870	829	1,700	870	829	1,700
メモリ	932	1,067	2,000	932	1,067	2,000
デザインサービス	602	447	1,050	602	447	1,050
その他	66	134	200	66	134	200
売上高合計	11,677	11,822	23,500	11,677	11,822	23,500
営業利益	418	221	640	418	361	780

- 仕入値引債権とは
- 仕入値引債権の評価額変動リスク
- 調達在庫のレート変動リスク
- 決済時ドル調達レート変動リスク

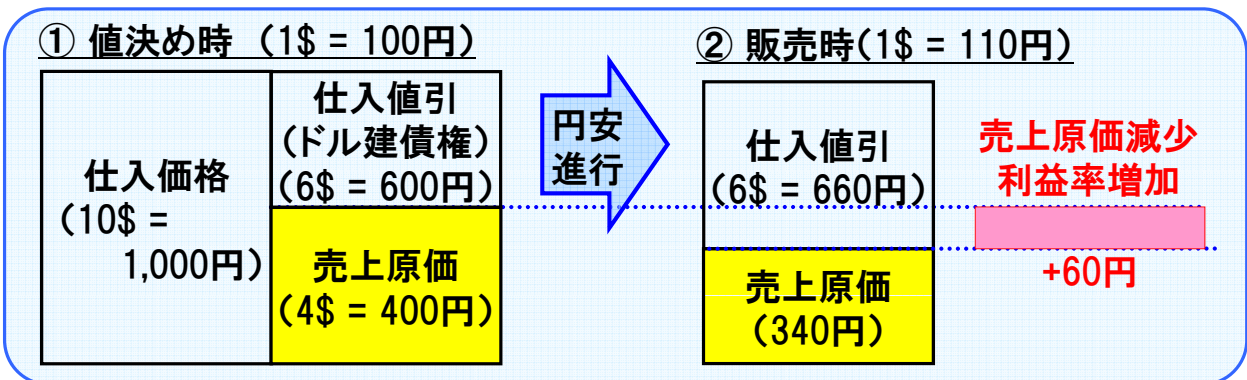
- 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
- その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
- その実現方法には、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」の2パターンがある



仕入値引債権の評価額変動リスク

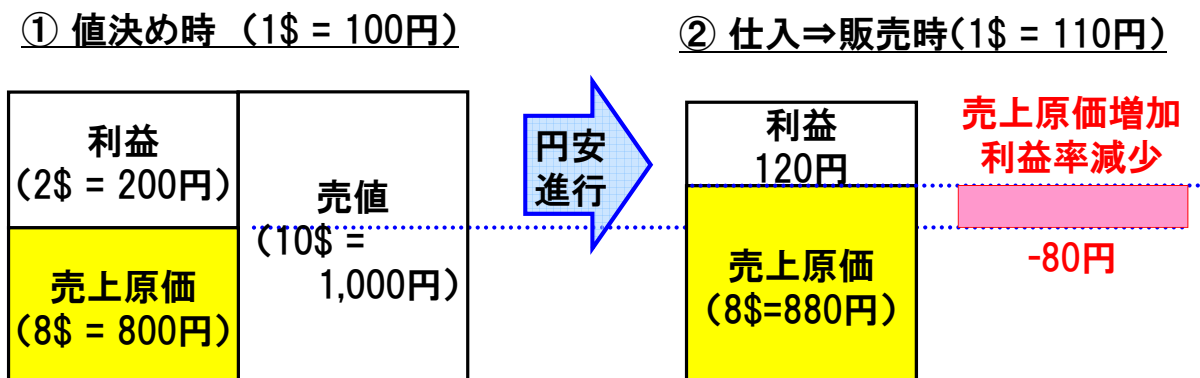
- ① 値決め : 量産案件では、標準仕入価格を下回る特別価格を適用することがある
- ② 販売 : 販売時に仕入値引(ドル建債権)を受け取る。値決め時よりも円安が進行している場合、仕入値引のドル建債権の評価額が増加

売上原価減少 → 利益率増加



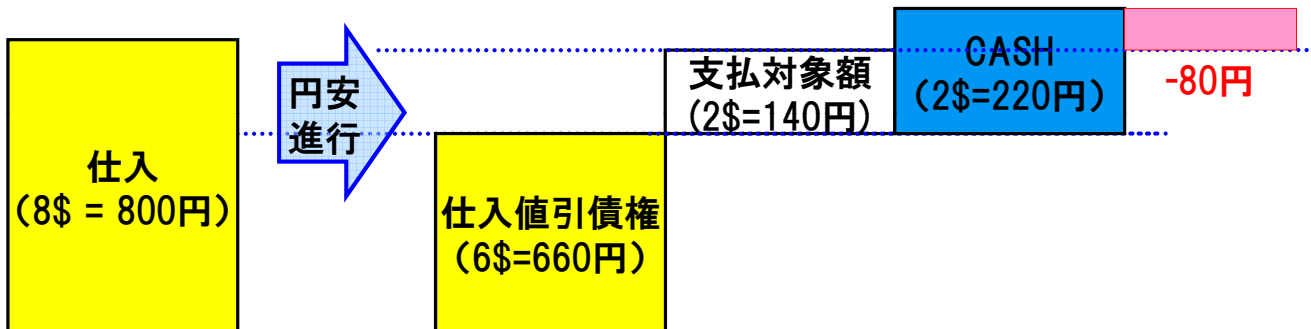
調達在庫のレート変動リスク

売上原価増加 → 利益率減少



① 仕入時 (1\$ = 100円) ② 販売・支払時 (1\$ = 110円)

決済差額



開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例:通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	リニアテクノロジー社等のアナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM、自社製品の販売
その他	上記のカテゴリに属さないソリューション

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

以下の担当までお問い合わせ下さい。

柴崎 由記（総務グループ IR担当）

株式会社PALTEK

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2016

FAX : 045-477-2012

E-mail : ir@paltek.co.jp